



Processor Intel® Core™ i3-4005U

pamięć podręczna 3 MB, 1,70 GHz

Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i3 czwartej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Haswell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Mobile
- Numer procesora i3-4005U
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q3'13
- Litografia 22 nm
- Rekomendowana cena klienta \$275.00

Wydajność

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 1,70 GHz
- Cache 3 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 5 GT/s DMI2
- TDP 15 W

Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 16 GB
- Rodzaje pamięci DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 4400
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 200 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 950 MHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 2 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) ‡ 3200x2000@60Hz
- Maks. rozdzielczość (DP) ‡ 3200x2000@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA) ‡ N/A

- Obsługa DirectX* 11.2/12
- Obsługa OpenGL* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI) Nie
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0xA16

Opcje rozszerzeń

- Obsługa PCI Nie
- Wersja PCI Express 2.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † 4x1, 1x4, 1x2
- Maksymalna liczba linii PCI Express 10

Specyfikacja I/O

- Liczba portów USB 4
- Wersja USB 3.0
- Łączna liczba portów SATA 2
- Zintegrowana karta sieci LAN Nie
- Zintegrowane IDE Nie
- Urządzenia IO ogólnego przeznaczenia Tak
- UART Tak
- Maksymalna liczba portów SATA 6,0 Gb/s 2

Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCBGA1168
- Maks. konfiguracja procesora 1
- T_{JUNCTION} 100°C
- Wymiary obudowy 40mm x 24mm x 1.5mm

Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost † Nie
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Nie
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Wersja oprogramowania Intel® ME Firmware 9.5
- Technologia Intel® HD Audio Tak
- Technologia Intel® Matrix Storage Nie
- Technologia Intel® ochrony tożsamości † Tak

- Technologia Intel® Matrix Storage Tak
- Technologia Intel® Smart Connect Tak
- Technologia Intel® Smart Response Nie

Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak
- Technologia Anti-Theft Tak